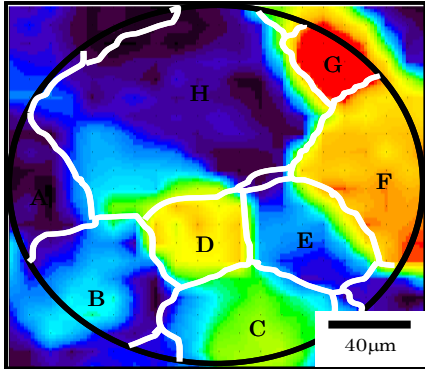


技術分野分類 4701：分析化学

技術キーワード L：状態分析

産業分類 E-28：電子部品・デバイス・電子回路製造業

| | | |
|-------------------|---|--|
| 内 容 | 概要 | ラマン散乱分光法は非弾性散乱現象を利用した非破壊材料分析法であり、現在数多くの材料の分析に使用されています。無機結晶構造解析だけでなく、非晶質物質にも適用可能であり、可視光レーザー514.5nmを励起源として用いているため、光学顕微鏡、集光レンズ、ピエゾステージを用いて、微細な部位の構造をマッピングしながら分析（空間分解能 $\sim 2\mu\text{m}$ ）が可能(写真)です。 |
| | 従来技術・競合技術との比較（優位性） | 無機の結晶材料だけでなく、非晶質物質を対象にした微細な部位の構造をマッピングしながら分析（空間分解能 $\sim 2\mu\text{m}$ ）が可能です。 |
| | 本技術の有用性 | 多結晶セラミックスの結晶方位分析、半導体材料の電子輸送特性解析、太陽電池材料の構造解析などについて、研究室の装置で成果を上げています。 |
| 関連情報 (図・表・写真等) |  | |
| 適用可能製品 | 光分析 材料解析 | |
| 技術 シーズ 保有者 | 氏名 所属・役職 | 早川知克 大学院工学研究科未来材料創成工学専攻・准教授 |
| 技術 シーズ 照会先 | 窓口 TEL/FAX e-mail | 産学官連携センター 052-735-5627 / 052-735-5542 c-socc@adm.nitech.ac.jp |

■知的財産

■試作品状況 無 提示可 提供可

作成日 2011年 11月 30日